



中华人民共和国国家标准

GB/T 14113—93

半导体集成电路封装术语

Terminology of packages for
semiconductor integrated circuits

1993-01-21 发布

1993-08-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 引用标准	(1)
3 通用术语	(1)
4 结构术语	(3)
5 技术、工艺术语	(5)
附录 A 中文索引(参考件)	(10)
附录 B 英文索引(参考件)	(11)

中华人民共和国国家标准

半导体集成电路封装术语

GB/T 14113—93

Terminology of packages for
semiconductor integrated circuits

1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体集成电路封装在生产制造、工程应用和产品交验等方面使用的基本术语。
本标准适用于与半导体集成电路封装相关的生产、科研、教学和贸易等方面的应用。

2 引用标准

GB 9178 集成电路术语

3 通用术语

3.1 封装 package

半导体集成电路的全包封或部分包封体,它提供:

- 机械保护;
- 环境保护;
- 外形尺寸。

封装可以包含或提供引出端,它对集成电路的热性能产生影响。

3.2 底座 header

封装体中用来安装半导体芯片并已具备了芯片焊接(粘接)、引线键合和引出端等功能的部分,它是封装结构的基体。

3.3 底板 base

在陶瓷或金属封装中,构成底座的一种片状陶瓷或金属零件。

3.4 盖板(管帽) cap

在陶瓷封装或金属底座上,采用金属或陶瓷制成片状或帽状结构,封接后对整个封装形成密封的一个零件。

3.5 上框 window frame

装在陶瓷封装表面上的一个金属或陶瓷件在其上可焊接一个用于密封的盖板。

3.6 引线框架 leadframes

采用冲制或刻蚀工艺制造,使具有一定几何图形和规定外形尺寸,提供陶瓷熔封或塑料封装引出线的一个或一组金属零件。引线框架各部位名称见图 1a 和图 1b。